

第三届集成芯片和芯粒大会

THE 3rd INTEGRATED CHIPS AND CHIPLET CONFERENCE

第三届集成芯片和芯粒大会邀请函

敬启者：

以“设计封装协同，共筑芯未来”为主题的第三届集成芯片和芯粒大会将于 2025 年 10 月 10-13 日在武汉万达瑞华酒店举行。

本次大会由武汉大学、中国科学院计算技术研究所、复旦大学主办，由孙凝晖研究员和刘明教授共同担任大会主席，由刘胜教授担任大会执行主席。随着信息时代对算力的需求不断提升，集成芯片与芯粒技术在电子设备、通信系统、人工智能等领域的应用日益广泛并成为推动行业创新与变革的重要力量。本次大会将汇聚集成芯片和芯粒相关领域的专家学者和企业同仁共同探讨集成芯片与芯粒技术的前沿动态与未来发展趋势。

我们非常荣幸邀请您参加此次大会，共同探讨集成芯片技术的发展趋势。如有其他需要，请提前与组委会联系。最后向您致以诚挚的问候！

附件：会议详细信息

第三届集成芯片和芯粒大会组委会

武汉大学动力与机械学院

2025 年 8 月 25 日



附件：会议详细信息

1、会议主办单位

武汉大学

中国科学院计算技术研究所

复旦大学

2、会议承办单位

武汉大学动力与机械学院

武汉大学集成电路学院

武汉大学前沿交叉学科研究院

湖北江城实验室

3、会议信息

报到时间：2025 年 10 月 10 日（周五）14:00-21:00

会议时间：2025 年 10 月 11-13 日（周六、周日、周一）

报到地点：武汉万达瑞华酒店一层

会议地点：武汉万达瑞华酒店（武昌区东湖路 138 号）

4、注册费标准

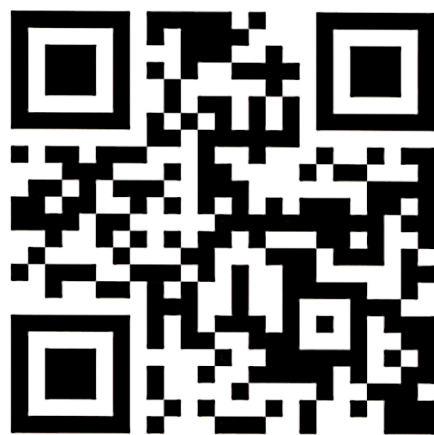
早鸟票学生票价格为 800 元(不含晚宴), 非学生票价格为 1600 元, 截止时间为 2025 年 9 月 20 日。

正常会议注册学生票价格为 1000 元(不含晚宴), 非学生票价格为 2000 元。

门票类型	参会者身份	早鸟票截止时间 2025 年 9 月 20 日 24 点 正常会议注册 2025 年 9 月 20 日之后
会议注册费 (早鸟票)	学生	¥800
	非学生	¥1600
会议注册费	学生	¥1000
	非学生	¥2000

5、注册和支付方式

扫描下方二维码，或登录会议官方网站
(<https://www.icccconf.cn/>) 完成注册后，点击“注册缴费”→提交信息→“确认报名”→“选择支付宝或微信”缴费即可。



大会主页二维码



会议注册二维码

6、联系方式

会务联系人：

洪老师 18205616321

张老师 18086083304